



性能特点

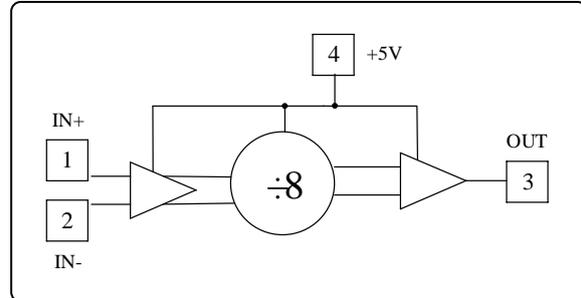
工作频段: 0.1-15 GHz

输出功率: -3 dBm

单电源供电: +5V @ 100 mA

芯片尺寸: 1.5 × 0.6 × 0.1 mm³

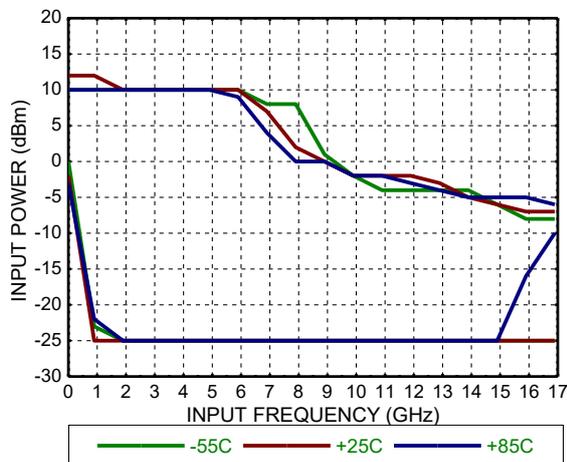
功能框图



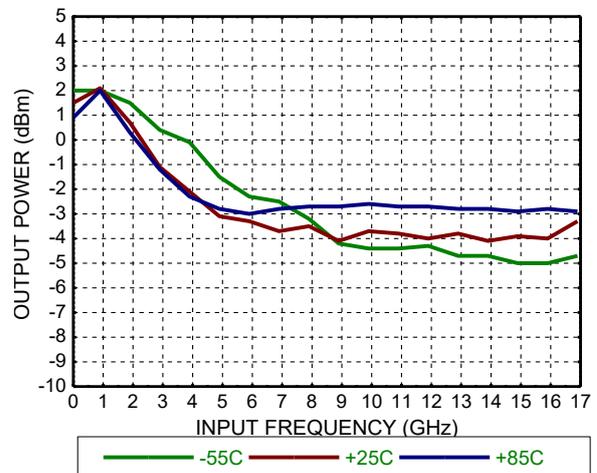
电特性参数 (T_A = +25°C, VDD = +5 V, IDD = 100 mA)

参数	条件	最小	典型	最大	单位
最高输入频率	正弦波		15		GHz
最低输入频率	正弦波		0.1		GHz
输入功率范围	f _{IN} = 0.1 – 15 GHz	-25	-10	+10	dBm
输出功率	f _{IN} = 0.1 – 15 GHz		-3		dBm
单边带相位噪声	P _{IN} = 0 dBm, f _{IN} = 6 GHz		-150		dBc/Hz
工作电流	+5V		100		mA

输入灵敏度窗口 vs. 温度

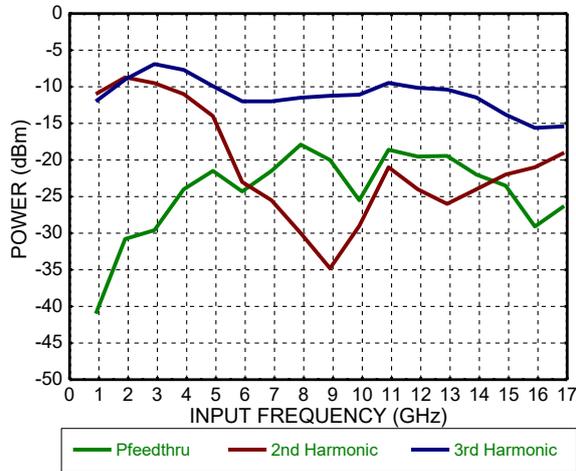


输出功率 vs. 温度

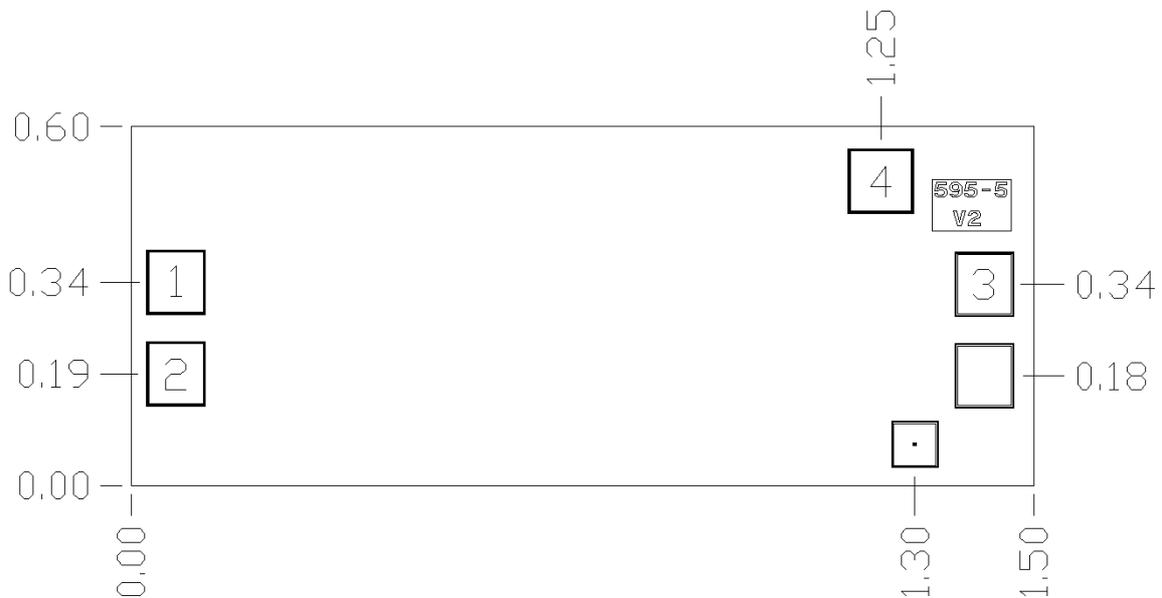




输出谐波, Pin=0dBm, T=25°C

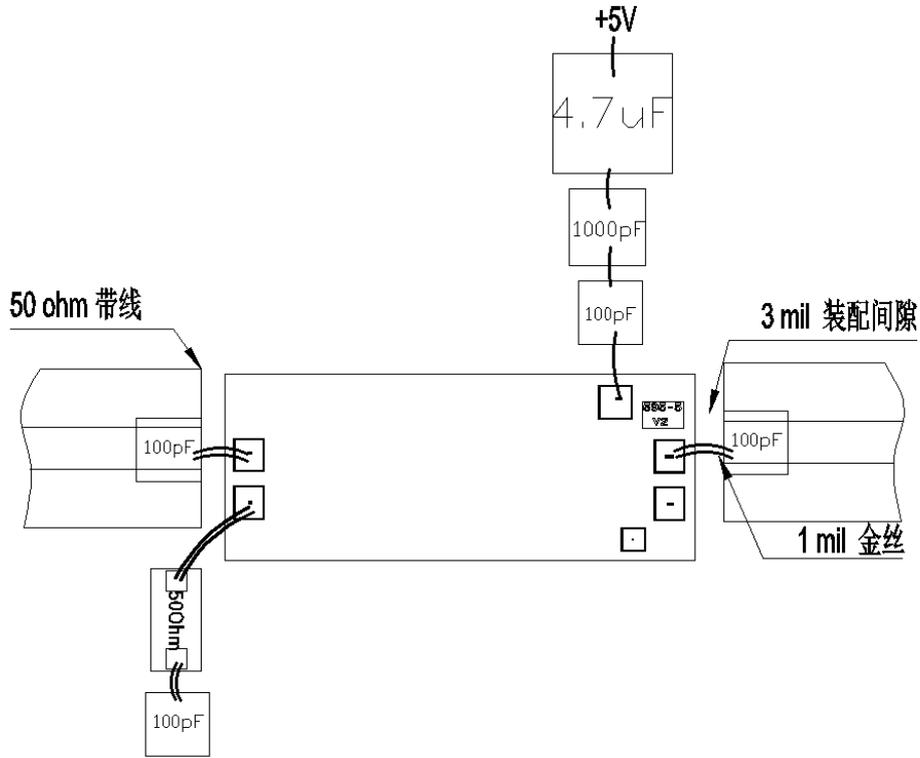


物理参数





装配图



注：该装配图为单端使用情况，输入输出引脚均需接 100pF 隔直电容。

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN+	该焊盘是射频输入端（需外接 100pF 隔直电容）
2	IN-	该焊盘是射频输入端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）与焊盘 1 相位相差 180°
3	OUT	该焊盘是分频信号输出端（需外接 100pF 隔直电容）
4	+5V	该焊盘是+5V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至地

极限参数

供电电压：+5.5V

储存温度：-65~+150°C

工作温度：-55~+125°C